

bga焊接 迅驰

产品名称	bga焊接 迅驰
公司名称	合肥迅驰电子科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区合欢路16号天怡商务中心2号创业楼二层
联系电话	13856069009 13856069009

产品详情

要想成功焊接BGA，首先要了解它的特点：BGA IC是属于大规模集成电路的一种，是主要针对体积小的电子产品开发的，因它的管脚位于IC的底部，虽然可以节省大部分空间但是因其管脚非常密集，所以非常容易造成虚焊.脱焊。故障率还算是很高的。对于预热温度，这个应当依据室温以及PCB厚薄情况进行灵活调整，比如在冬天室温较低时可恰当进行预热温度，而在夏日则应相应的下降一下。若PCB板比较厚，也需要恰当进行一点预热温度，详细温度因BGA焊台而异，有些焊台PCB固定高度距焊台预热砖较近，能够夏日设在100-110摄氏度摆布，冬天室温偏低时设在130-150摄氏度若间隔较远，则应进步这个温度设置，详细请参照各自焊台阐明书。BGA封装的优点：BGA封装很牢靠，同20mil间距的QFP相比，BGA没有可以弯曲和折断的引脚。它像砖头一样牢靠。

BGA的焊接考虑和缺陷：.焊料成团，再流焊后，板上疏松的焊料团如不去除，工作时可导致电气短路，也可使焊缝得不到足够的焊料。形成焊料团的原因有以下几种情况: · 对于焊粉、基片或再流焊预置没有有效地熔融，bga焊接价格，形成未凝聚的离散粒子。 · 焊料熔融前(预加热或预干燥)焊膏加热不一致，造成焊剂活性降级。 · 由于加热太快造成焊膏飞溅，形成离散的焊粉或侵入到主焊区外面。 · 焊膏被湿气或其它高"能量"化学物质污染，从而加速溅射。 · 加热期间，含超细焊粉的焊膏被有机物工具从主焊区带走时，在焊盘周围形成晕圈。 · 焊膏和焊接防护罩之间的相互作用。BGA封装的优点：一个本身就很小的封装，有很好的散热属性。硅片贴在上面的话，大多数热量可以向下传播到BGA的球阵列上如果硅片是贴在底面的话，那么硅片的背部是和封装的顶部相连接，这是很合理的散热方法焊接留意第4点：适当的运用助焊剂！BGA助焊剂在焊接进程中含义特殊！不

管是从头焊接还是直接补焊，咱们都需求先涂上助焊剂。芯片焊接时可用小毛刷在整理洁净的焊盘上薄薄的涂上一层，尽量抹均匀，千万不要刷的太多，不然也会影响焊接。在补焊时可用毛刷蘸取少数助焊剂涂改在芯片附近即可。助焊剂请选用BGA焊接的助焊剂！

焊接注意事项：每次植锡完毕后，要用清洗液将植锡板清理干净，以便下次使用。锡膏不用时要密封，以免干燥后无法使用。需备防静电吸锡笔或吸锡线，在拆卸集成块，特别是BGA封装的IC时，将残留在上面的锡吸干净。焊接留意第4点：适当的运用助焊剂！BGA助焊剂在焊接进程中含义特殊！不管是从头焊接还是直接补焊，咱们都需求先涂上助焊剂。芯片焊接时可用小毛刷在整理洁净的焊盘上薄薄的涂上一层，尽量抹均匀，千万不要刷的太多，不然也会影响焊接。在补焊时可用毛刷蘸取少数助焊剂涂改在芯片附近即可。助焊剂请选用BGA焊接的助焊剂！焊接留意第5点：芯片焊接时对位一定要准确。由于咱们的返修台都配有红外扫描成像来辅佐对位，这一点应当没什么疑问。假如没有红外辅佐的话，咱们也能够参照芯片附近的方框线来进行对位。留意尽量把芯片放置在方框线的中心，稍微的偏移也设太大疑问，由于锡球在熔化时会会有一个主动回位的进程，轻微的方位偏移会主动回正！

bga焊接价格-迅驰(推荐商家)由合肥迅驰电子科技有限公司提供。合肥迅驰电子科技有限公司在电子、电工产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，迅驰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。